


<div></div> <div>인천광역시</div>		<div>보도자료</div>		<div>GLOBAL TOP 10 CITY</div> <div>INCHEON</div>	
		<div>배포일자</div>	<div>2024년 6월 28일(금)</div> <div>총 4매</div>		<div>세계 10대 도시 인천</div>
<div>담당 부서</div>	<div>반도체바이오과</div>	<div>담당자</div>	<div>• 반도체산업팀장 박혜윤 ☎440-4296</div> <div>• 담당자 노승진 ☎440-4299</div>		
<div>사진(이미지)</div>	<div><input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 있음</div>		<div>참고자료</div>	<div><input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 있음</div>	
<div>보도시점</div>		<div>배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.</div>			

**인천 반도체산업의 미래를 여는 기술교류회 성료**  
**- 최신 어드밴스드 패키징 장비·재료 기술 로드맵 및 산학연 정부과제 동행 -**  
**- 인천반도체포럼 주최 반도체산업 기술 공유의 장 열려 -**

인천광역시는 6월 28일 오라카이 송도파크호텔에서 ‘인천반도체포럼 기술교류회’를 개최했다고 밝혔다.

시는 2021년 12월, 인천 반도체산업의 지속 가능한 성장을 위해 ‘인천반도체포럼’을 출범했으며, 현재 산업계·유관기관·연구기관·대학·고등학교 등 48개 기관이 포럼 회원사로 등록돼 반도체산업 전반에 걸친 네트워크를 구축하고 있다.

인천반도체포럼 주최, 인천반도체포럼·인천테크노파크(TP) 주관 및 인천시 후원으로 개최된 기술교류회는 회원사 관계자 80여 명이 참여한 가운데 ‘최신 어드밴스드 패키징 장비·재료 기술 로드맵 및 산학연 정부과제 동행’을 주제로 진행됐다.

기술교류회는 국가정보원 지부의 ‘경쟁국의 기술 탈취 및 대응방안 실태’에 대한 주제로 시작됐다. 국가정보원은 발표에서 첨단기술은 기업의 성장과 국가 경제발전의 원동력이므로, 기술보호에 대한 기업의 적극적인 노력과 관심을 강조했다.

성균관대학교 양원석 교수가 ‘반도체 관련 기술동향’을 주제로 현재 반도체산업이 가지고 있는 기술 동향을 소개하며 급변하는 반도체 시장의 트렌드와 필요한 기술 등을 소개하는 시간을 가졌다.

스태츠칩팩코리아 김영철 부사장은 ‘최신 패키징 기술동향과 로드맵 및 수요’ 강연을 통해 반도체 첨단패키징의 로드맵과 기술개발을 듣는 시간이 이어졌다.

또한, 한국생산기술연구원 지능화뿌리연구소 방정환 지역산업혁신부문장의 ‘반도체 패키징 연구개발(R&D) 동향 및 정부지원사업 현황’ 발표와 인천반도체포럼 회원사 제품·기술 소개를 통해, 인천 반도체 기업 간의 협력체계 강화와 정부과제 동향에 따른 대응방안에 대해 논의했다.

유제범 시 미래산업국장은 “오늘 기술교류회는 인천시의 반도체 기업들이 주요 기술을 공유하고 나아가 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 기회”라며 “급변하는 반도체산업 속 인천반도체포럼이 탄탄한 네트워크를 기반으로 반도체산업 발전에 중추적인 역할을 계속할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

- <붙임> 1. 인천반도체포럼 포스터  
2. 인천반도체포럼 개요

※ 관련 사진은 16시 이후 인천시 홈페이지 ‘보도자료’에 게시될 예정입니다.



## 붙임2

## 인천반도체포럼 개요

### □ 개 요

- (행 사 명) 최신 어드밴스드 패키징 장비·재료 기술 로드맵 및 산학연 정부과제 동행
- (일 시) 2024. 6. 28.(금) 14:00 ~ 18:00
- (장 소) 오라카이 송도파크호텔 2층 릴리홀
- (주요내용) ①기술유출 실태, ②반도체 기술동향, ③회원사 제품·기술 소개
- (주최/주관) 인천반도체포럼 / 인천TP, 인천반도체포럼
- (후 원) 인천광역시
- (참 석 자) 회원사 및 관계자 등 80명 예정

### □ 세부일정(안)

일 정	주요내용	비고
14:00~14:30 (30')	참석 회원사 간 차담회	
14:30~14:35 (5')	환영사 및 인사말씀	인천반도체포럼회장/ 인천광역시미래산업국장
14:35~15:05 (30')	강연① 경쟁국의 기술탈취 및 대응방안 실태	국가정보원
15:05~15:35 (30')	강연② Semiconductor Tech Trend & Smart Convergence 그리고 Forum Synergy Products	성균관대학교 양원석 교수
15:35~15:45 (10')	휴식	
15:45~16:15 (30')	강연③ Advanced Packaging Technology Trend and Roadmap for AI and HPC products	스태츠칩팩코리아 김영철 부사장
16:15~16:35 (30')	강연④ 반도체 패키징 R&D 동향 및 정부지원사업 현황	한국생산기술연구원 방정환 부문장
16:35~17:35 (60')	회원사 회사소개 및 Q&A	
17:35~17:40 (5')	폐회 및 장내 정리	
17:40~18:00	만찬	

\* 상기 일정은 행사 진행 상황에 따라 변경될 수 있음